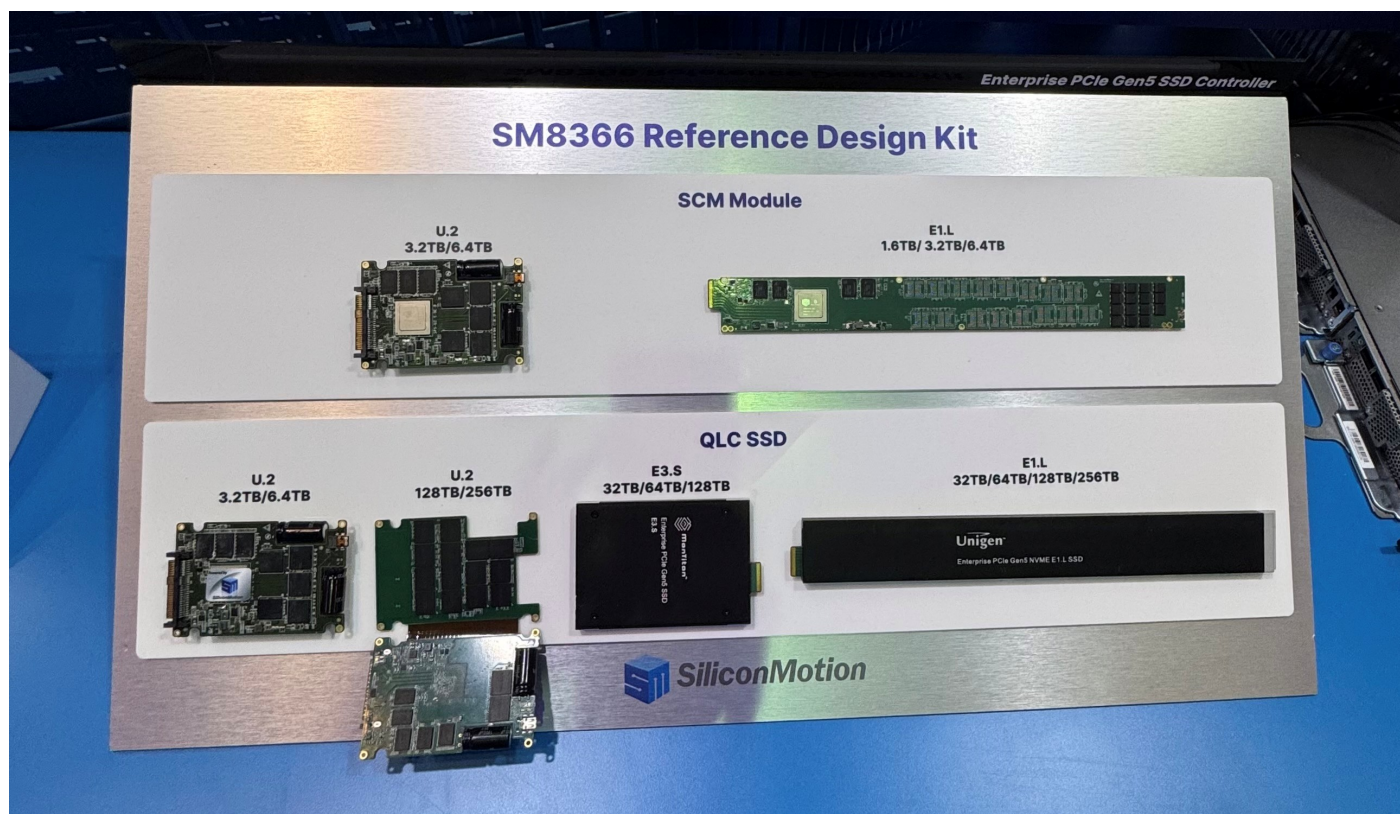




慧荣科技FMS2026发布新一代PerformaShape™技术, 专为智能体AI基础设施设计

August 10, 2026

全球 NAND 闪存主控芯片领导厂商慧荣科技(NasdaqGS: SIMO)于 FMS2026 上发布了其全新MonTitan® SSD参考设计套件(RDK), 搭载其新一代专利PerformaShape™技术。该平台专为智能体 AI (Agentic AI) 基础设施设计, 使企业级 SSD 能够充当持久内存层, 支持 KV Cache 卸载和自主 AI 智能体, 同时为动态、常驻运行的智能体 AI 工作负载提供可预测的 QoS、持续稳定的性能以及优化的耐用性。



智能体AI重新定义企业存储需求

与传统 AI 应用不同, AI 智能体会持续进行推理、行动、上下文保留以及与外部工具的交互, 产生多样化的数据类型和快速变化的访问模式。随着 AI 数据中心支持持续的多步推理和日益庞大的 KV Cache, 企业级SSD必须提供高吞吐量、稳定的延迟、可预测的 QoS, 以及持续高强度写入操作所需的耐用性。

实现可预测 SSD QoS 的新一代架构

新一代 PerformaShape™技术引入了增强型硬件架构, 旨在通过多维整形(Multi-Dimensional Shaping)实现更精细的工作负载管理。结合集成的性能监控功能, 并以 NVMe TP4176 作为 API 接口, 该技术可帮助企业级 SSD 在多租户和多智能体场景中复杂且快速变化的工作负载下保持可预测的 QoS。

“AI 智能体要求存储演进为能够保留上下文并支持持续自主操作的持久内存层,”慧荣科技企业级产品营销高级总监 Jason Chien 表示。“搭载新一代 PerformaShape™技术, 我们的全新 MonTitan® SSD RDK 将增强的硬件与软件相结合, 能够高效管理跨多个智能体的数据流, 减少资源争用, 并加速智能体AI存储解决方案的上市时间。”

PerformaShape™技术已集成到慧荣科技的 SM8366 PCIe 5.0 和 SM8466 PCIe 6.0 两款企业级 SSD 主控芯片中。基于这些平台构建的 MonTitan® SSD RDK 为 SSD 制造商提供了可扩展的基础, 用于开发面向AI服务器和数据中心的存储解决方案, 帮助其缩短开发周期, 并加速智能体AI应用的上市时间。

关于慧荣科技

慧荣科技(Silicon Motion Technology Corporation, NasdaqGS: SIMO)是全球固态存储设备NAND Flash 主控芯片领域的创新厂商。公司为服务器、个人电脑及其他边缘设备提供的 SSD 主控芯片出货量居世界前列, 同时也是智能手机、物联网产品及汽车应用中所用 eMMC 和 UFS 嵌入式存储主控芯片的主要供应商。

慧荣科技为企业级 SSD、边缘 SSD、嵌入式 UFS 及 eMMC 提供定制化高性能主控芯片方案，以及企业级启动盘和汽车级 Ferri 存储方案。其主控芯片与存储解决方案专为驱动全球最先进的 AI 基础设施、边缘 AI 及物理 AI 而设计，融合了高性能、低功耗与久经验证的可靠性。